

**华虹半导体有限公司**  
**(HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED)**

**与**

**上海华虹(集团)有限公司**

**上海集成电路产业投资基金股份有限公司**

**国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司**

**上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)**

**之**

**发行股份购买资产协议之补充协议**

**二〇二五年十二月**

## 发行股份购买资产协议之补充协议

本《发行股份购买资产协议之补充协议》(以下简称“本补充协议”)由以下各方于 2025 年 12 月 31 日于上海市签订:

**甲方:** 华虹半导体有限公司(HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED)

注册地址: 香港中环夏慤道 12 号美国银行中心 2212 室

**乙方:** 上海华虹(集团)有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区碧波路 177 号

法定代表人: 秦健

**丙方:** 上海集成电路产业投资基金股份有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区春晓路 289 号 1201 室 A 单元

法定代表人: 李鑫

**丁方:** 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司

注册地址: 北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层 701-6

法定代表人: 张新

**戊方:** 上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)

主要经营场所: 中国(上海)自由贸易试验区中科路 1699 号 28 层 02 单元

执行事务合伙人: 上海国投先导私募基金管理有限公司

本补充协议上述五方合称“各方”, 单称“一方”。

除非本补充协议另有定义, 否则本补充协议项下定义与各方于 2025 年 8 月 29 日签署之《发行股份及支付现金购买资产协议》(以下简称“《资产购买协议》”)项下相应定义具有相同的含义。

**鉴于:**

1. 各方于 2025 年 8 月 29 日签署《资产购买协议》, 就甲方拟通过发行股份及支付现金

的方式购买乙方持有的华力微 63.5443%的股权、购买丙方持有的华力微 15.7215%的股权、购买丁方持有的华力微 10.2503%的股权、购买戊方持有的华力微 7.9827%的股权相关事宜进行了约定。

2. 经友好协商，各方一致同意，本次交易的交易对价均由甲方通过发行股份方式进行支付。
3. 《资产购买协议》第 1.5 条约定：“各方同意，本次交易甲方发行股份的数量将根据以发行股份形式向资产出售方支付的交易对价和发行价格确定，具体为：向各资产出售方发行的股份数量=以发行股份形式向各资产出售方支付的交易对价/发行价格。依据该公式计算的发行股份数量精确至股，不足一股的部分由甲方以现金补足。”
4. 《资产购买协议》第 15.4 条约定：“各方同意，待标的资产的审计、评估等工作完成后，各方应就确定标的资产的评估值、交易定价以及本次交易的发行股份数量等事项另行签订补充协议，同时，如涉及法律法规规定应进行业绩补偿的，相关方应就补偿事宜另行签订补偿协议。”
5. 担任本次交易审计机构的大华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具编号为大华审字[2025]0011016213 号《审计报告》；担任本次交易资产评估机构的上海东洲资产评估有限公司(以下简称“东洲评估”)已出具编号为东洲评报字【2025】第 2446 号《华虹半导体有限公司拟发行股份购买资产所涉及的上海华力微电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(以下简称“《评估报告》”)。

经各方友好协商，现就本次交易相关事宜达成本补充协议如下：

## **第一条 标的资产交易对价及对价支付**

- 1.1 根据东洲评估以 2025 年 8 月 31 日为评估基准日出具的《评估报告》，华力微全部权益的评估值为 848,000 万元。

基于上述评估结果，经各方协商一致，本次交易标的资产的交易对价为 826,790.215326 万元。根据《资产购买协议》的相关约定，各方同意各资产出售方的交易对价金额及甲方向各资产出售方发行的股份数量如下表所示：

资产出售方	出售华力微股权 比例(%)	交易对价金额 (万元)	向该资产出售方 发行的股份(股)
乙方	63.5443	538,855.119569	124,332,053
丙方	15.7215	133,318.646521	30,761,109
丁方	10.2503	86,922.766501	20,056,014
戊方	7.9827	67,693.682735	15,619,216
合计	<b>97.4988</b>	<b>826,790.215326</b>	<b>190,768,392</b>

各方同意，甲方向资产出售方发行股份的数量合计为 190,768,392 股，发行股份数量最终以中国证监会予以注册的数量为准。若发行价格根据《资产购买协议》第 1.4 条的约定作出调整的，则甲方向资产出售方发行股份的数量将根据调整后的发行价格按照中国证监会和上交所有关规定作相应调整。

各方同意，如经有权国资监管机构备案的评估结果与上述华力微股东全部权益评估结果不一致的，各方将经内部有权机构批准后基于经备案的评估结果重新确定本次交易的交易对价，并就此另行签署补充协议。

## 第二条 过渡期损益安排

- 2.1 本次交易以市场法作为主要评估方法，未以基于未来收益预期的估值方法作为主要评估方法，经各方友好协商，本次交易过渡期(自评估基准日(不含当日)起至交割日(含当日)止)期间，标的资产的盈利、亏损由甲方享有或承担。
- 2.2 资产出售方同意，除应遵守《资产购买协议》及本补充协议其他约定外，其在过渡期内应遵守如下 2.2.1-2.2.3 的约定，并促使华力微遵守如下 2.2.3-2.2.8 的约定：
- 2.2.1 保证持续拥有标的资产的合法、完整的所有权，不得以任何形式处置标的资产，确保标的资产不存在司法冻结、质押或其他类型权利负担；
- 2.2.2 未经甲方事先书面同意，不会自行放弃任何因标的资产形成的物权或债权，亦不以标的资产承担任何其自身或他方的债务；

- 2.2.3 未经甲方事先书面同意,不发起、寻求、磋商、谈判或进行其他任何形式的与华力微相关的股权性融资活动;
- 2.2.4 未经甲方事先书面同意,不减少、增加华力微的注册资本,不对华力微采取任何合并、分立、中止经营、并购、重组、清算、申请破产或类似其他影响华力微经营的行为,不从事任何非正常的导致华力微价值减损的行为;
- 2.2.5 未经甲方事先书面同意,宣布分配或者实际分配华力微的利润、股息或红利;
- 2.2.6 未经甲方事先书面同意,不发起、寻求、磋商、谈判或进行其他任何形式的与华力微相关的股权性融资活动;
- 2.2.7 未经甲方事先书面同意,不对华力微公司章程进行对本次交易构成实质性影响的调整;
- 2.2.8 在华力微的日常经营过程中,保证华力微将谨慎、合理地对待其所拥有的资产和负担的债务,避免因未尽管理职责而发生的资产减损、负债增加的情形。

甲方同意,在决定是否同意上述事项时应遵循符合华力微正常生产经营及发展需要的原则。

### **第三条 其它**

- 3.1 各方理解并同意,本补充协议构成《资产购买协议》的补充;本补充协议与《资产购买协议》约定不一致的,以本补充协议为准;本补充协议未约定的,仍然适用于《资产购买协议》的相关约定。
- 3.2 本补充协议自各方签署之日起成立,除本补充协议另有约定外,本补充协议自《资产购买协议》生效之日起生效。
- 3.3 本补充协议正本壹式拾份,各方各执壹份,其余报政府主管部门审批、核准及办理过户登记手续之用。

(本页以下无正文，下附签署页)

(本页为《发行股份购买资产协议之补充协议》之签署页)

甲方：华虹半导体有限公司(HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED)(盖章)

授权代表： 王 鹏 (签署)



(本页为《发行股份购买资产协议之补充协议》之签署页)

乙方: 上海华虹(集团)有限公司(盖章)

授权代表: 康健 (签署)





(本页为《发行股份购买资产协议之补充协议》之签署页)

丙方：上海集成电路产业投资基金股份有限公司(盖章)

授权代表：\_\_\_\_\_ (签署)



(本页为《发行股份购买资产协议之补充协议》之签署页)

丁方：国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(盖章)

授权代表：  (签署)



(本页为《发行股份购买资产协议之补充协议》之签署页)

戊方：上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)

授权代表：   汪  斌   (签署)

